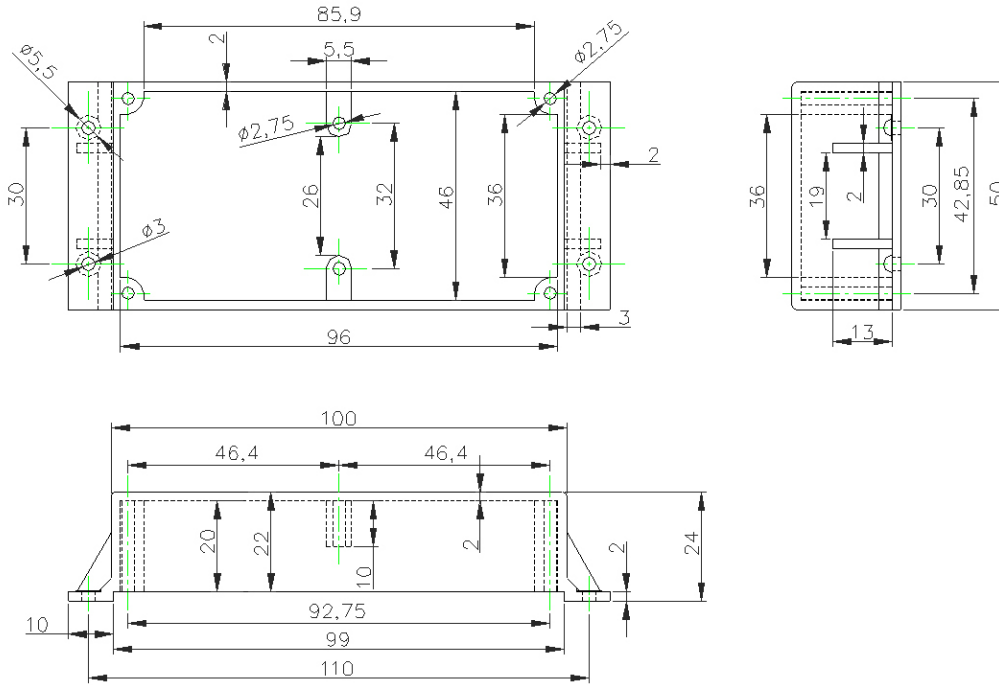


Modul- Gehäuseoberteil



Modul- Gehäuseoberteil schwarz.

Modul- Gehäuseoberteil mit offenem Boden und Befestigungsmöglichkeit für eine Platine.

Gehäuse wird nach Einsetzen und Anschliessen der Platine mit Giessharz verschlossen.

[Verwendungsbereich]		[Zul. Abw.]	[Oberfl.]	Maßstab 1:1	[Gewicht]
G070 Modul-Gehäuse mit Befestigungsloschen				[Werkstoff, Halbzeug]	Thermoplast
		Datum	Name	MODUL-GEHÄUSE lang	
		Bearb. 22.11.15	M.SIMON		
		Gepr.			
		Norm			
				G070	Blatt 1 von 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ersatz für:	Ersatz durch:
			KEMO-Electronic GmbH		